

6616



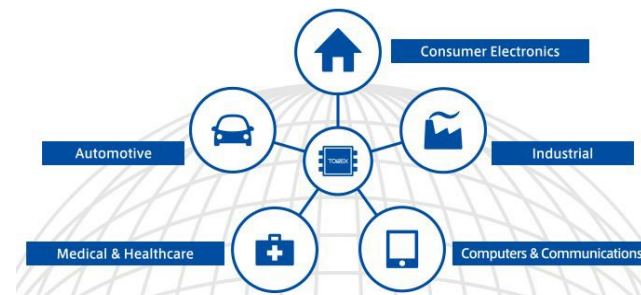
# 2024年3月期 通期 決算説明資料

2024年5月17日

トレックス・セミコンダクター株式会社

世界は「アナログ」でできている

あらゆるフィールドで活躍するトレックスの電源IC



**1**

**2024年3月期 通期業績**

**2**

**2025年3月期 業績予想**

**3**

**株主還元**

**4**

**トピックス**

**Appendix**

# 2024年3月期 通期業績

▶ **トレックスは、半導体市場の低迷が継続し、売上が大きく減少。棚卸評価損と減損損失も影響し、減収減益**

▶ **フェニテックは、中国を中心としたアジア向けが大きく減少し、減収減益**

▶ **対業績予想は、トレックスにおける棚卸評価損の増加と、減損損失の発生により大きく未達**

(単位：百万円)

科目	23.3期通期 実績	24.3期通期 実績	対前年同期比 増減率
売上高	31,956	25,751	▲19.4%
営業損益	3,976	▲1,778	-
営業利益率	12.4%	-	-
経常損益	3,981	▲2,452	-
親会社株主に帰属する 当期純損益	2,179	▲4,297	-
EPS (円)	198.69	▲390.73	-
海外売上高比率 (*1)	70.0%	66.5%	▲3.5pt
平均為替レート (1\$=)	¥134.9	¥144.4	-
減価償却費	1,645	2,350	42.9%
設備投資	4,850	5,284	8.9%

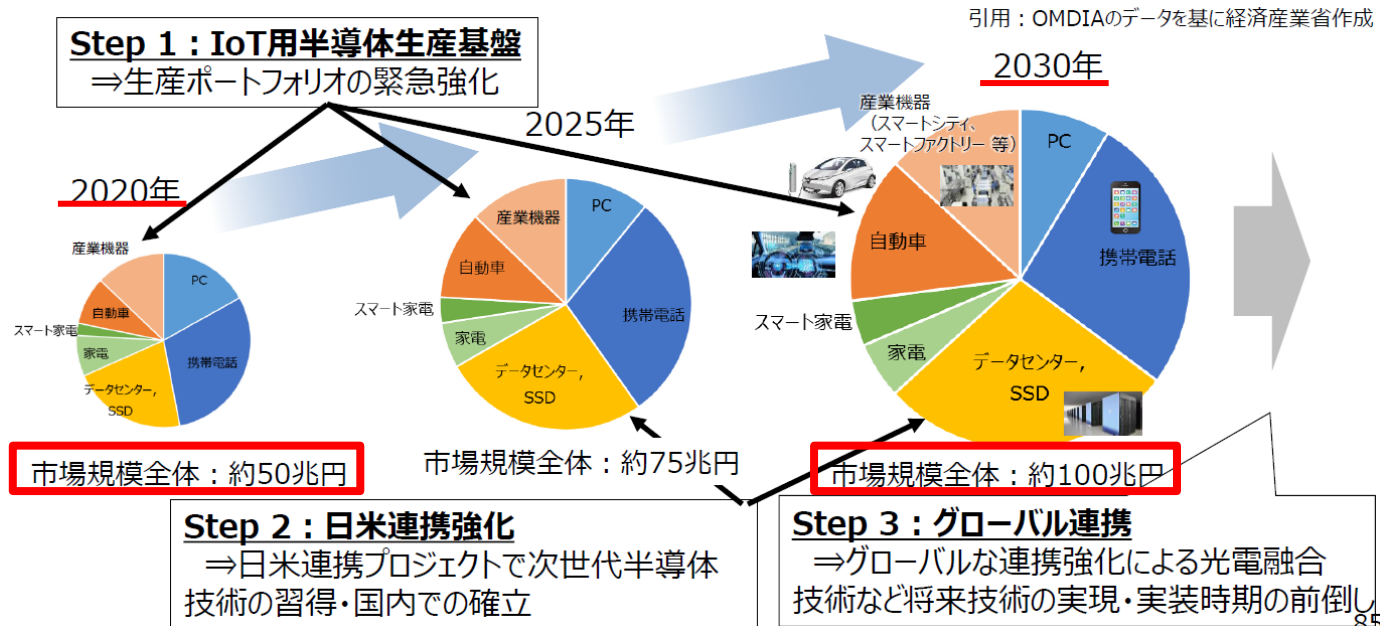
(\*1)海外売上高比率：外貨建て売上比率

## ● 半導体市場規模は2020年から2030年で倍の100兆円規模に

3. 半導体・デジタル産業戦略（令和3年6月公表）の実施状況 （1）半導体分野

### 我が国半導体産業復活の基本戦略

- IoT用半導体生産基盤の緊急強化（Step: 1）
- 日米連携による次世代半導体技術基盤（Step: 2）
- グローバル連携による将来技術基盤（Step: 3）

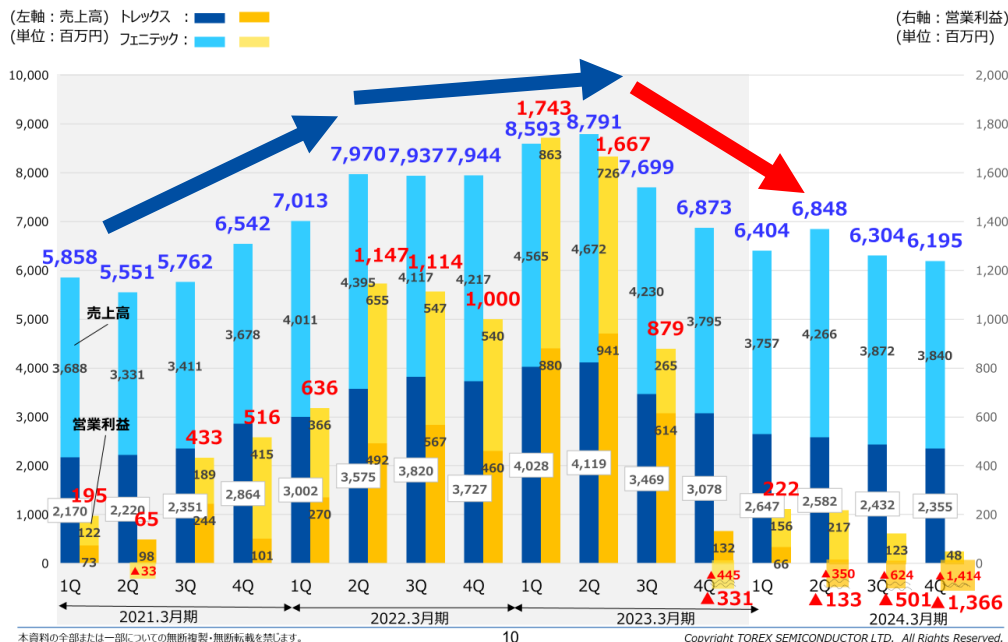


85

経済産業省発表資料より

## ● 半導体市場の急成長と当社の売上

### 売上高・営業利益の四半期推移



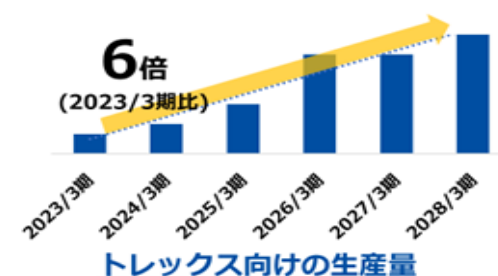
当決算説明資料 P.10 より

## ● 生産キャパ不足に伴う海外ファウドリへの投資

### 生産キャパ確保と増産投資

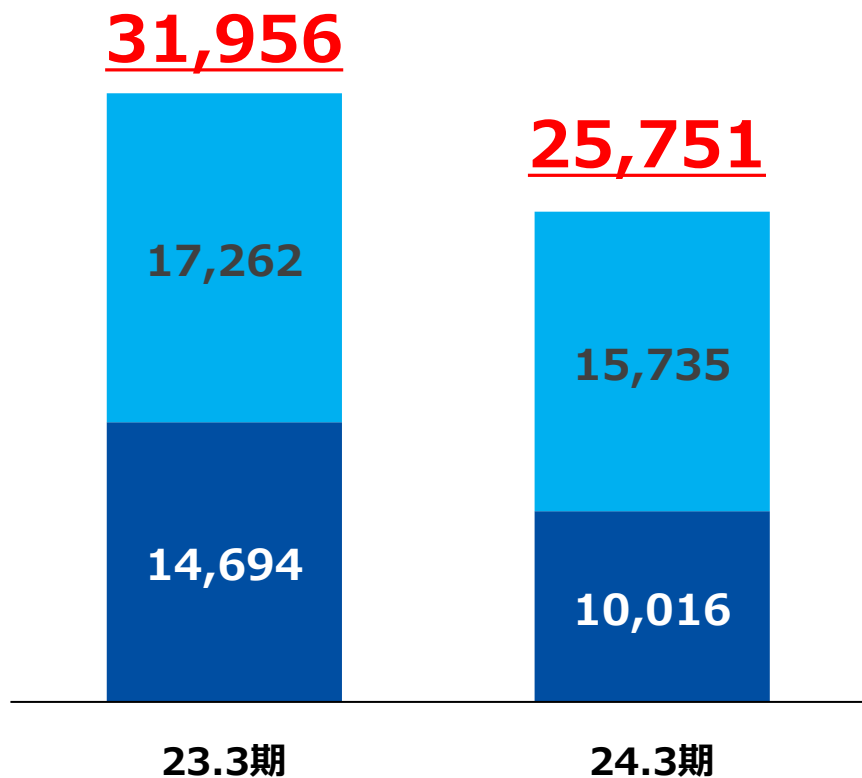
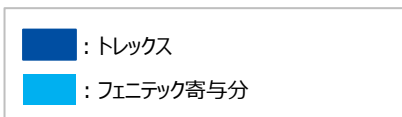
#### ● 海外ファウドリ1社と長期生産委託契約を締結

- ・委託先の工場増設に当社資金を一部充当し、中高耐圧を含む、高機能/高性能な新製品の展開に必要な 8インチ生産枠を確保
- ・25/3期生産ラインが量産稼働予定
- ・投資額：18億円



当社 2023年3月期 通期決算説明資料より

(単位：百万円)



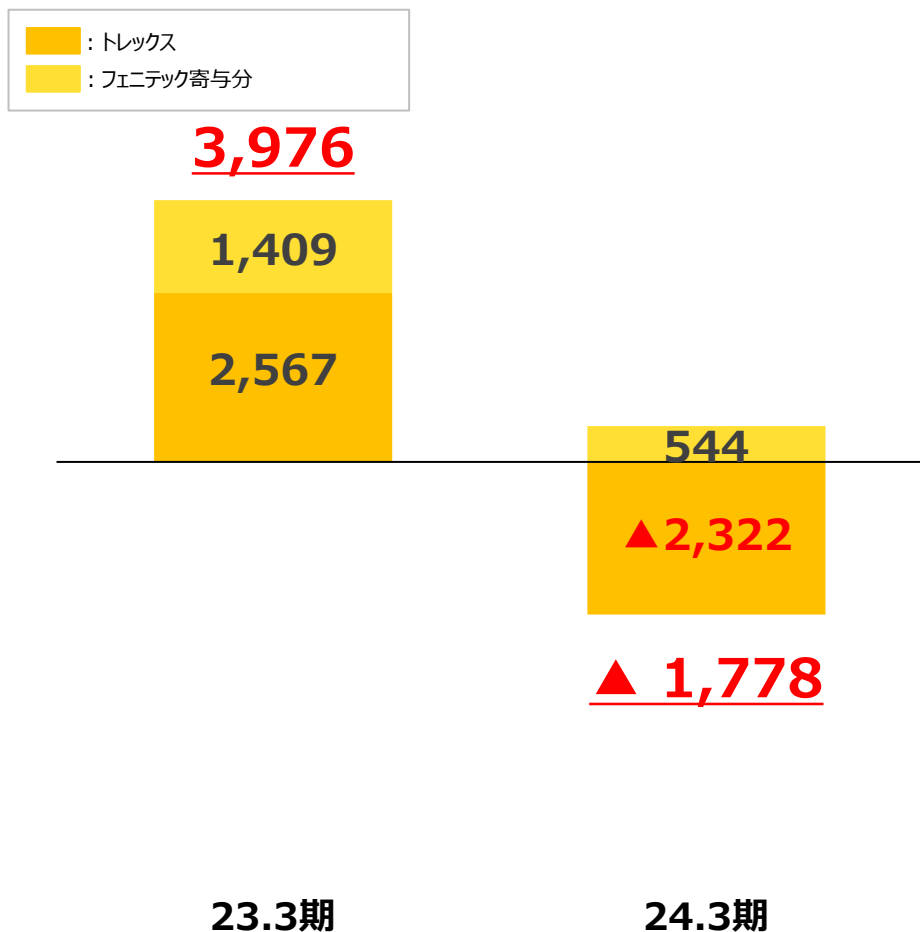
- トレックス (前年同期比▲31.8%)
  - 半導体市場の継続的な低迷により、大きく減少
  - 全てのアプリケーション分野で減少
- フェニテック (前年同期比▲8.8%)
  - 中国市場の低迷を受けて減収
  - 一般民生機器分野などで大きく減少

(単位：百万円)

	23.3期 実績	24.3期 実績	対前年同期比増減率
売上高	31,956	25,751	▲19.4%



(単位：百万円)

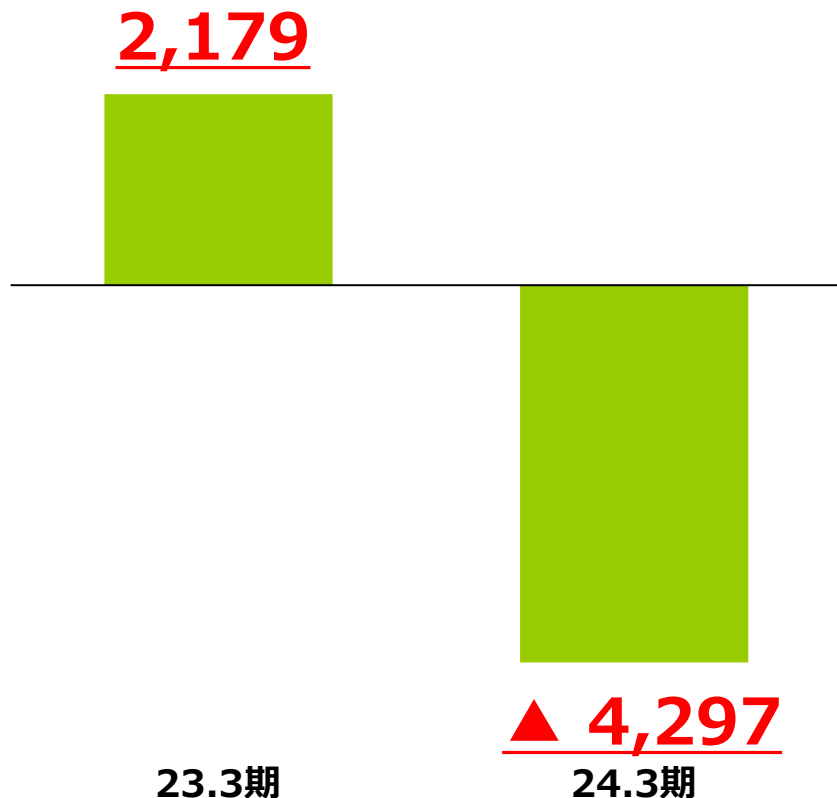


- トレックス (前年より48億89百万円減)
  - 売上の減少と棚卸評価損など※の発生により、営業損失に転じる
  - ※ 影響額：約23.3億円
- フェニテック (前年同期比▲61.4%)
  - 売上の減少に伴い、減益

(単位：百万円)

	23.3期 実績	24.3期 実績	前年との差
<b>営業損益</b>	<b>3,976</b>	<b>▲1,778</b>	<b>▲5,754</b>

(単位：百万円)



各段階利益の減少及び為替差損、減損損失により、当期純損失に転じる。また、繰延税金資産の取り崩しによる法人税等調整額への影響により損失が増加。

- ・ 為替差損 : 約 6.4億円
- ・ 減損損失 : 約17.0億円
  - TRX生産ラインに対する損失 : 14.4億円
  - PTS第2工場に対する損失 : 2.5億円
- ・ 法人税等調整額への影響額 : 約12.0億円

(単位：百万円)

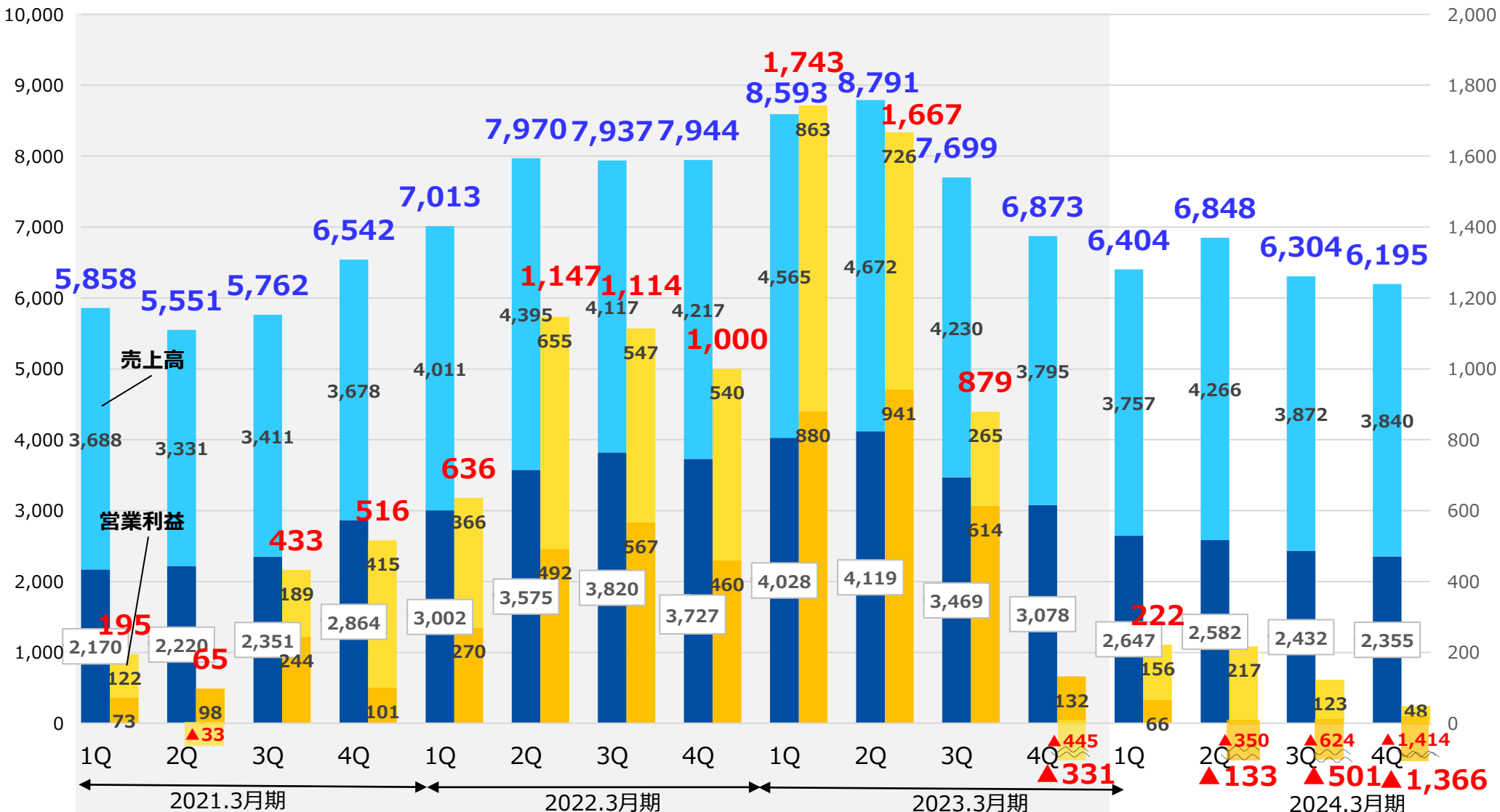
	23.3期 実績	24.3期 実績	前年との差
四半期純損益	2,179	▲4,297	▲6,477

# 売上高・営業利益の四半期推移



(左軸：売上高) トレックス : ■ ■  
 (単位：百万円) フェニテック : ■ ■

(右軸：営業利益)  
 (単位：百万円)



(単位：百万円)

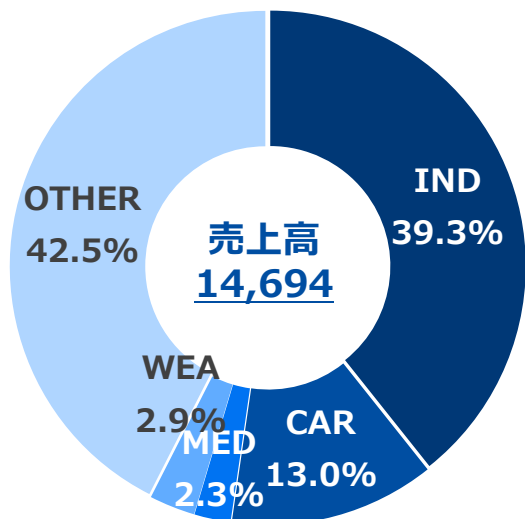
科目	23年3月期末	24年3月期末	対前期末増減
資産	37,048	36,636	▲412
負債	12,454	16,083	3,629
純資産	24,593	20,552	▲4,041

## &lt;参考&gt; キャッシュ・フロー関連指標の推移

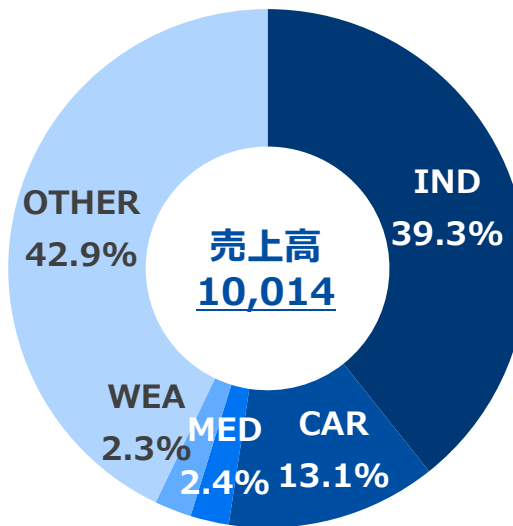
科目	23年3月期末	24年3月期末	対前期末増減
有利子負債	7,734	11,314	3,580
自己資本比率	66.4%	56.1%	▲10.3pt
D/Eレシオ	0.31	0.55	0.24

# トレックス／フェニテック 各単体

TOIREX



23.3期実績



24.3期実績

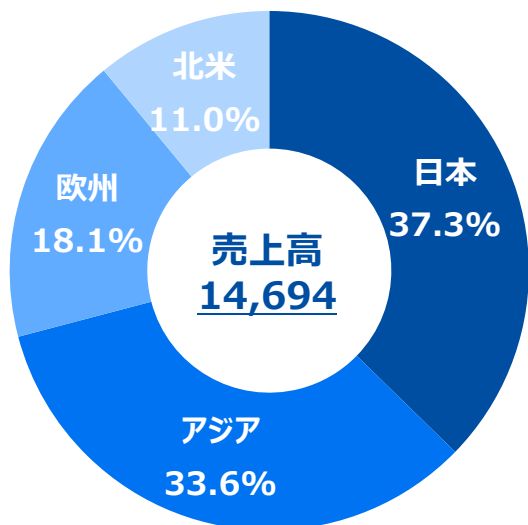
(単位：百万円)

アプリケーション	23.3期		24.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	5,770	39.3%	3,934	39.3%	▲31.8%
CAR 車載機器	1,908	13.0%	1,315	13.1%	▲31.1%
MED 医療機器	336	2.3%	240	2.4%	▲28.6%
WEA ウェアラブル機器	431	2.9%	226	2.3%	▲47.6%
OTHER その他機器	6,245	42.5%	4,299	42.9%	▲31.2%

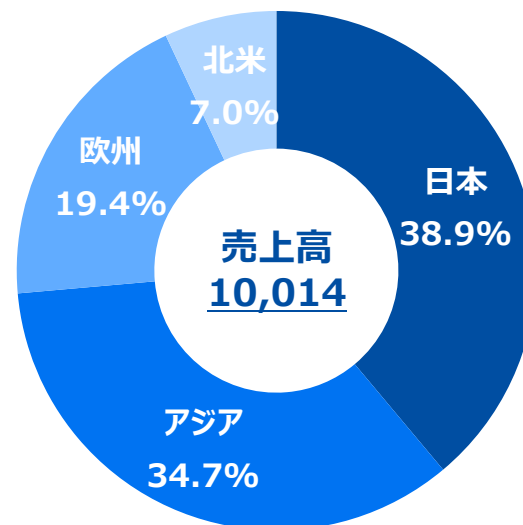
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。

# 2024年3月期 ～地域別売上高 (トレックス)

TOIREX



**23.3期実績**

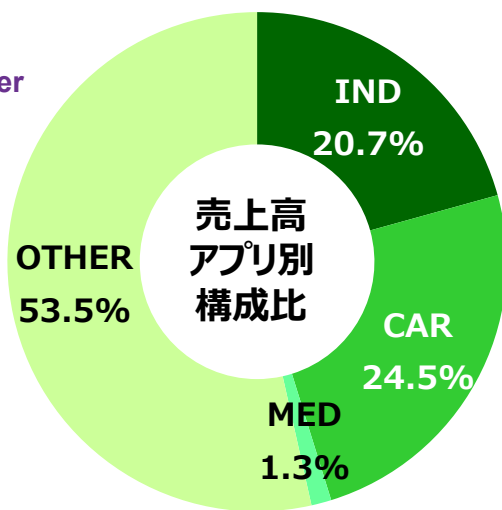


**24.3期実績**

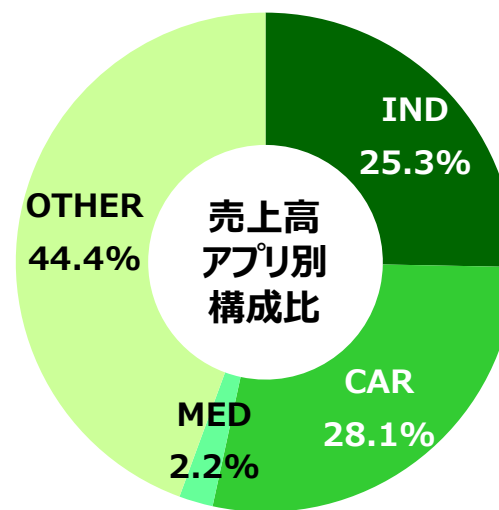
(単位：百万円)

地域 (D-in)	23.3期		24.3期		対前年同期比 増減率
	D-in 売上高	構成比	D-in 売上高	構成比	
日本	5,474	37.3%	3,892	38.9%	▲28.9%
アジア	4,944	33.6%	3,477	34.7%	▲29.7%
欧州	2,657	18.1%	1,942	19.4%	▲26.9%
北米	1,617	11.0%	703	7.0%	▲56.5%
平均為替レート (1\$=)	134.9円		144.4円		-

D-in 売上高：デザイン・イン・ベース売上高。当社の製品を搭載した製品が企画・設計され、実質的に受注を獲得した地域をベースとした売上高



**23.3期実績**



**24.3期実績**

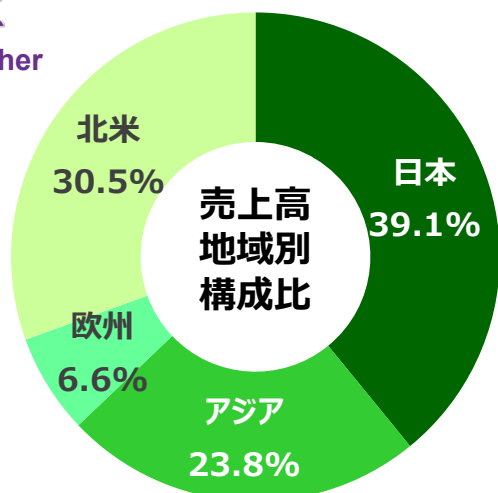
(単位：百万円)

アプリケーション	23.3期		24.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
IND 産業機器	4,026	20.7%	4,287	25.3%	6.5%
CAR 車載機器	4,757	24.5%	4,757	28.1%	0%
MED 医療機器	252	1.3%	379	2.2%	50.4%
OTHER その他機器	10,413	53.5%	7,536	44.4%	▲27.6%

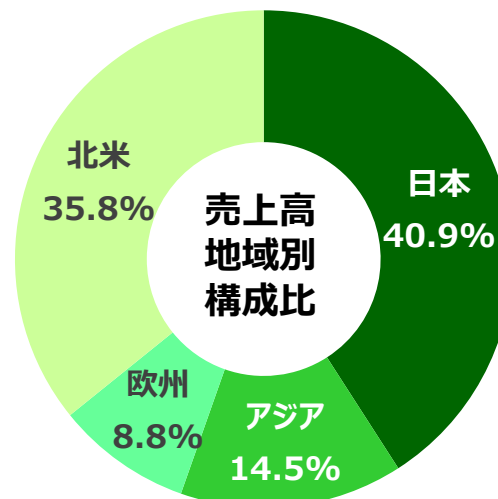
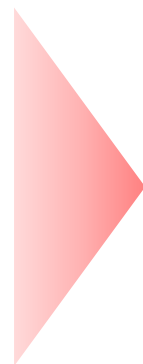
※注：アプリケーションの分類は変更することがあります。  
トレックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む



# 2024年3月期 ～地域別売上高（フェニテック）



**23.3期実績**



**24.3期実績**

※ 顧客の所在地別に区分しています。

(単位：百万円)

地域（顧客）	23.3期		24.3期		対前年同期比 増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
日本	7,609	39.1%	6,936	40.9%	▲8.8%
アジア	4,620	23.8%	2,462	14.5%	▲46.7%
欧州	1,295	6.6%	1,490	8.8%	15.1%
北米	5,924	30.5%	6,071	35.8%	2.5%
平均為替レート（1\$=）	134.9円		144.4円		

※注：日本には、トックス・セミコンダクター向けの内部取引分を含む

# 2025年3月期 業績予想

# 2025年3月期 業績予想 P/L概要及び主要指標

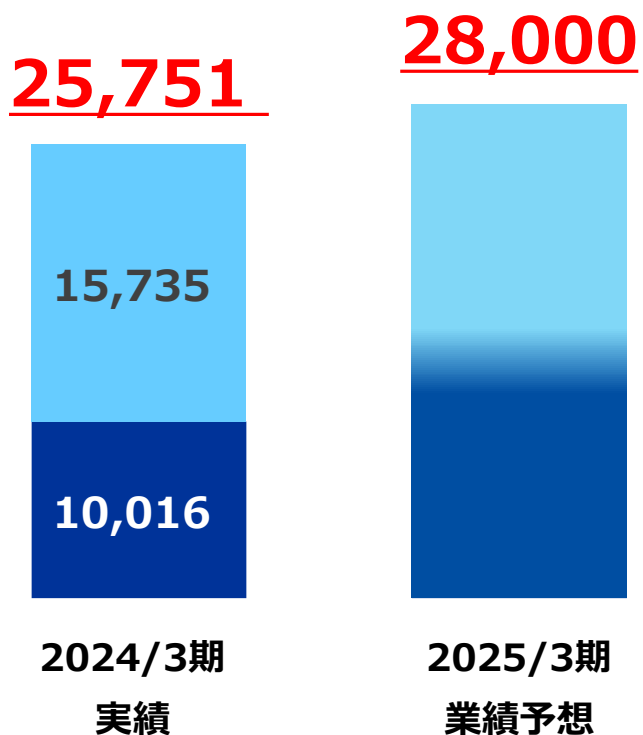


(単位：百万円)

	24.3期 通期実績	25.3期 業績予想	対前年 同期比 増減率	備考
売上高	25,751	28,000	+8.7%	
営業損益	▲1,778	1,000	-	
営業利益率	-	3.6%	-	
経常損益	▲2,452	1,000	-	
親会社株主に 帰属する当期純損益	▲4,297	700	-	
EPS (円)	▲390.73	63.63	-	
平均為替レート (1\$=)	¥144.4	¥150.0	-	
減価償却費	2,350	3,000	+27.7%	
設備投資	5,284	3,600	▲31.9%	

(単位：百万円)

■ : トレックス  
■ : フェニテック寄与分



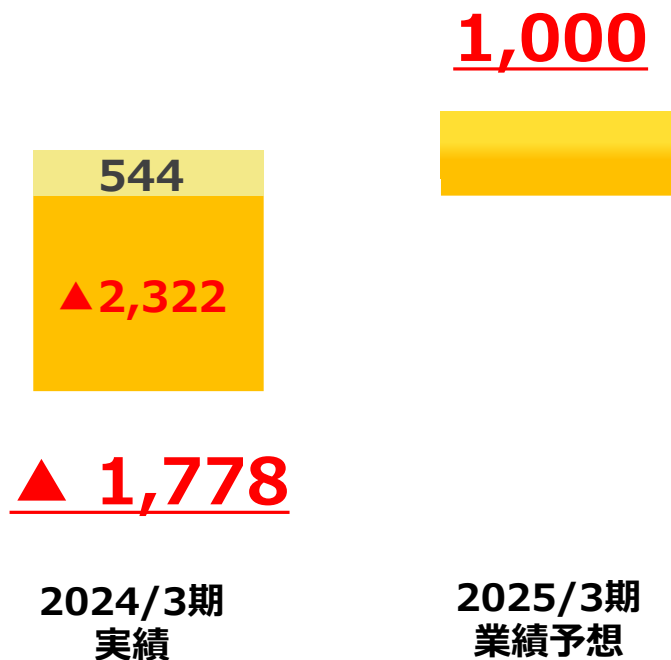
年後半からの半導体市況の回復を想定し、増収と予想

(単位：百万円)

	2024年3月期 実績	2025年3月期 業績予想	対前年増減率
売上高	25,751	28,000	+8.7%

(単位：百万円)

■ : トレックス  
 ■ : フェニテック寄与分



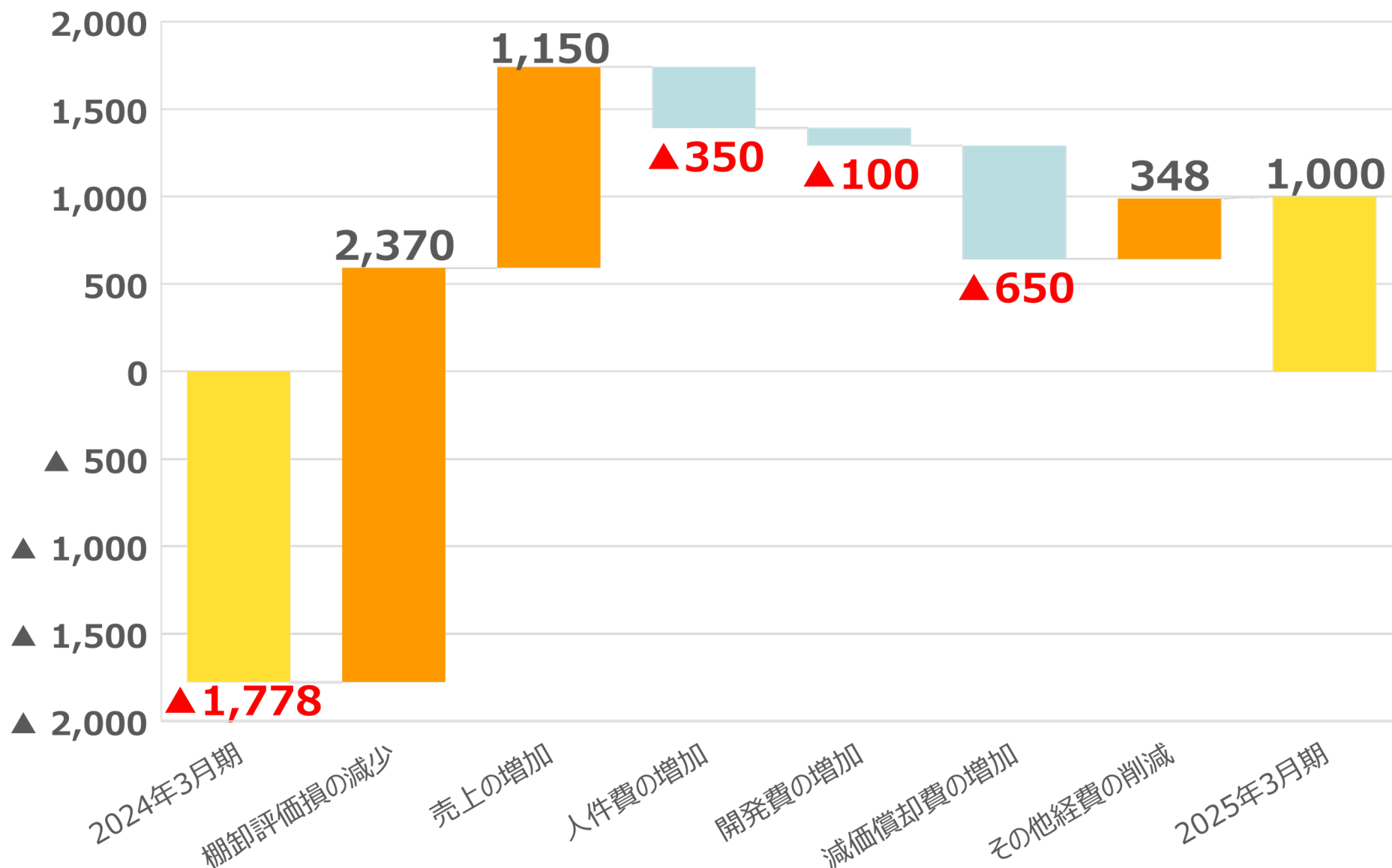
売上の増加と昨年発生したTRXにおける在庫の評価損の解消により大きく増加。

	2024年3月期 実績	2025年3月期 業績予想	対前年増減率
<b>営業損益</b>	<b>▲1,778</b>	<b>1,000</b>	—

# 2025年3月期 業績予想 営業損益②



(単位：百万円)



# 株主還元

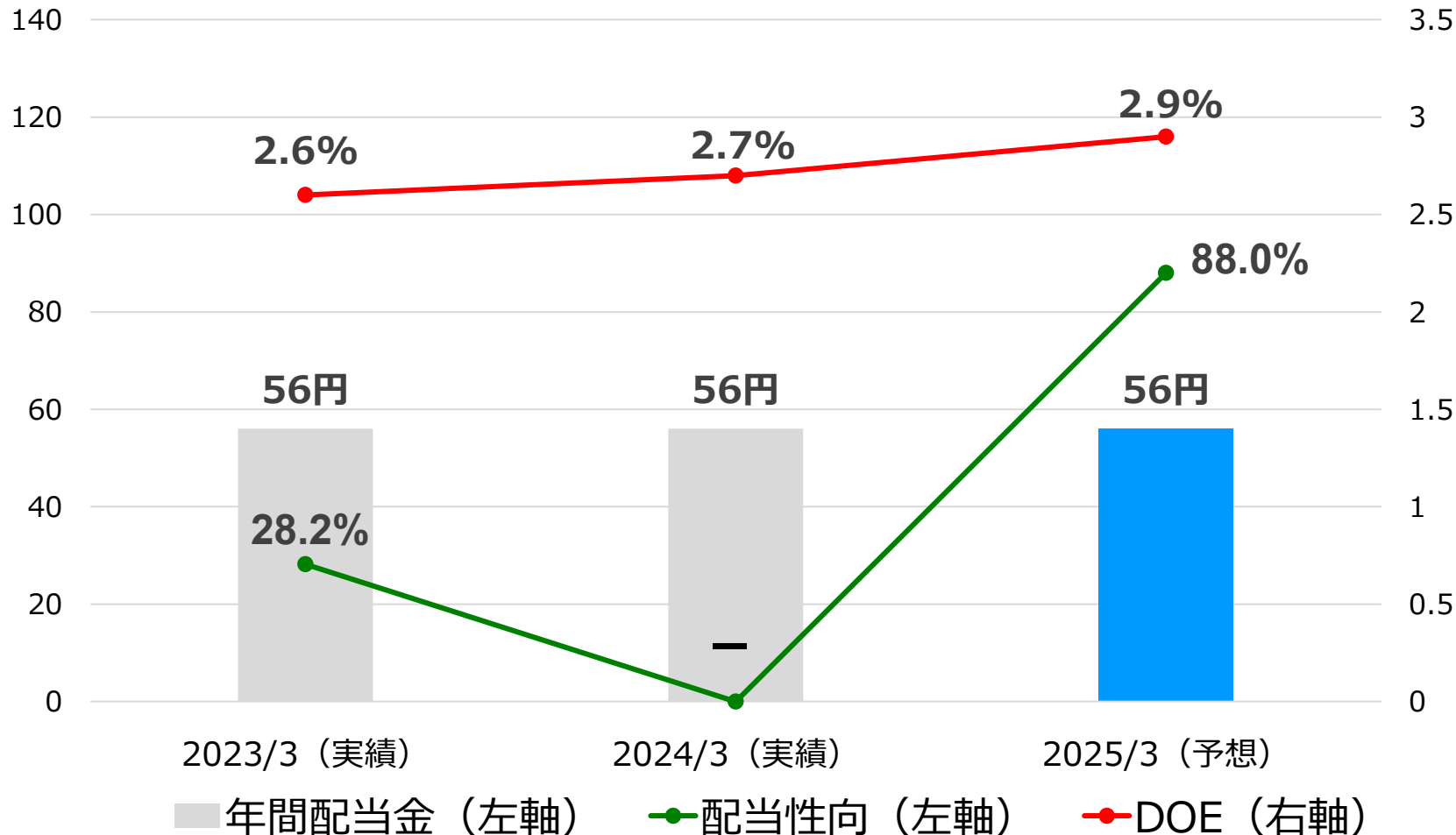
配当につきましては、業績水準を反映した利益配分として  
**連結配当性向20%以上**、安定的かつ継続的な株主還元  
の拡充として**株主資本配当率（D O E）3%程度**を当面  
の目標として実施しております。



## 連結配当性向20%以上、D O E 3%程度を目標として還元

配当金：円  
配当性向：%

DOE：%



# トピックス

# 2025年3月期 経営方針（抜粋）

# 2024年度 基本方針

「 Sustainable Development / **持続可能な発展** 」  
を実現するグループ企業へ

- サステナビリティ 3つの柱 -

・ 環境保護 (Environmental Protection)

DC/DC、XCL、パワーデバイスなど、環境に配慮した製品・サービスの提供

・ 社会開発 (Social Development)

従業員及び組織が成長し、満足して働ける環境を整備、構築

・ 経済発展 (Economic Development)

持続的な成長を実現するため、常にイノベーションを重視し、競争力の強化を図る

# 2024年度 経営方針

技術基盤を持つ企業として、半導体市場での存在価値を一層高めていく為の活動を推進。

- **中高耐圧製品の早期ラインナップ<sup>o</sup>（トレックス）**
  - 産業機器、車載に向けた 高性能／高品質 製品
  - DC/DCコンバータ、コイル一体型DC/DCコンバータ
- **パワーデバイスビジネス推進（フェニテック）**
  - オリジナル技術開発
  - SiCデバイス、Si（パワーMOSFET、IGBT）、酸化ガリウム

- **製品紹介**
- **パワーデバイス製品開発**

## 2023年度 リリース製品

DC/DCコンバータ : 10シリーズ製品

降圧DC/DCコンバータ

5シリーズ製品

コイル一体型 DC/DCコンバータ

5シリーズ製品



## < フェニテック鹿児島 電源ICの特長 >

低出力電圧対応、高性能、超小型、低消費電流、車載対応製品

- ・ 出力電流 : 150mA~1500mA (ドライバ MOSTr.内蔵)
- ・ 1.2mm×1.4mm や h0.75mm の 超小型製品

## 2024年度 リリース予定

昇圧DC/DCコンバータ製品拡充



## PWM/PFM制御 60V高耐圧 300mA 降圧DC/DC XC9702 シリーズ

- PWM、PWM/PFM自動切換制御
- 同期整流 ドライバ FET内蔵
- 入力電圧範囲 4.5V ~ 60V
- HSOP-8N、USP-10B

### 製品の特長

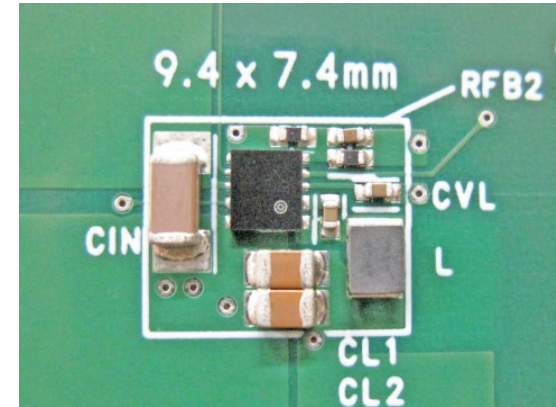
- 高効率、低リップル電圧
- 発信周波数：1MHz
- パワーグッド、UVLO 機能付
- サーマルシャットダウン、ショート保護
- インピーダンスやモーター等の負荷変動／誘導に対応

### ターゲットアプリケーション

12V/24Vラインからの高耐圧降圧

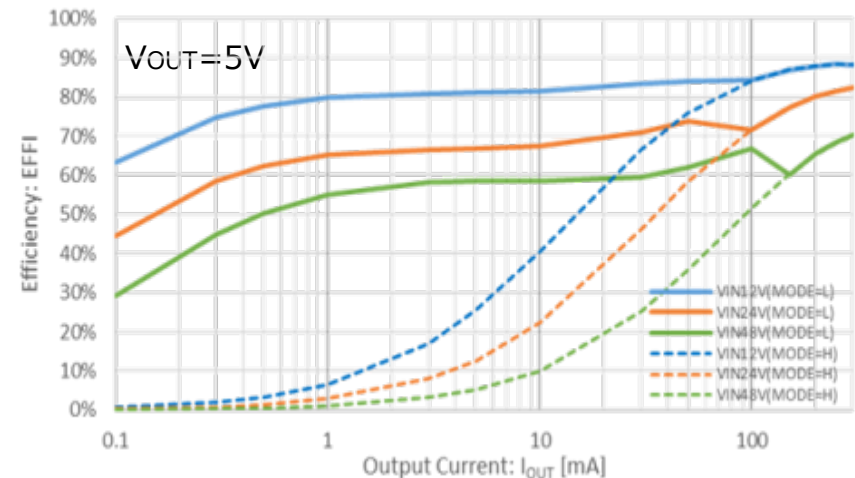
工場・ビル・施設などのセンサ／セキュリティ機器

FAの各種センサ



60V 300mA DC/DC  
世界最小クラスのソリューションサイズ

### 電力変換効率特性例





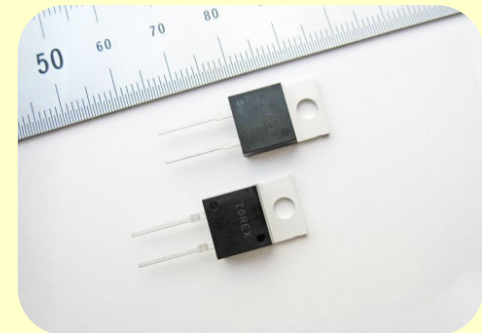
## ● トレックス 電源ICに加え、パワー半導体製品も強化

### パワー半導体事業拡大の専任組織を設置し、強力に推進

- ・ **MOS-FET**ラインナップ拡充（低V<sub>th</sub>製品、中耐圧大電流製品、低リーク）
- ・ **IGBT** 製品開発の検討
- ・ **SiC** 製品開発推進、製品の具体化
  - ⇒ **フェニテック製 SiC-SBD** トレックスよりPKG品サンプル提供中
  - ⇒ 順次、製品ラインナップを拡大
- ・ **酸化ガリウム**製品開発
  - ⇒ ノベルクリスタルテクノロジー社と共同開発

トレックスでは、フェニテックセミコンダクターが開発した、SiC ショットキーバリアダイオード 850V／10A品のサンプル提供を開始しました。

また、本製品を皮切りに順次 650V～1200Vの製品ラインナップ化を推進しております。



[SiC-SBD TO-220AC XBSC11A108CS](#)

## 評価されているトレックス製品

## トレックスの電源ICは、省電力/小型のスペックが評価されています。

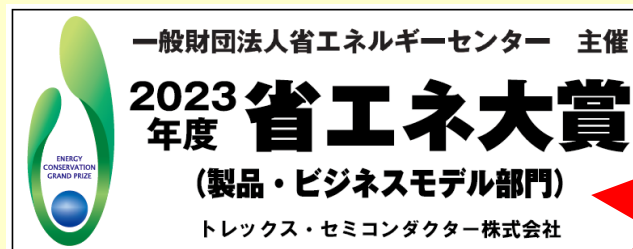
### 2023年度



日刊工業新聞主催

**XC9145シリーズ：昇圧DC/DCコンバータ**  
回路の消費電流を400nAまで低減したPWM/PFM制御方式を採用することで、軽負荷時、特に数 $\mu$ Aの出力電流における電力効率を50~60%改善しました。

奨励賞  
受賞



審査委員会  
特別賞受賞

**XC8110/8111シリーズ：ロードスイッチIC**  
理想的なダイオードを再現し、チップイネーブル(CE)、過電流制限、突入電流制限、サーマルシャットダウン機能等を搭載したロードスイッチICです。

### 2022年度



日刊工業新聞主催

**XC8110/8111シリーズ**  
ロードスイッチIC

### 2020年度



省エネルギーセンター主催

**XC9276シリーズ**  
DC/DCコンバータ

### 2019年度



日刊工業新聞主催

**XC9281/XC9282シリーズ**  
DC/DCコンバータ

### 2018年度



経済産業省主催

**XC9265シリーズ**  
DC/DCコンバータ

### 2018年度



日刊工業新聞主催

**XC6192シリーズ**  
ロードスイッチIC

# フェニテックセミコンダクター

## New Vision

### 2024年1月 ビジョンの一新

**ファウンドリ事業を通じ  
すべてのステークホルダーから信頼されることにより  
持続的成長を目指します**

For Further Growth Together

#### ファウンドリ事業

半導体前工程のウェハプロセス專業のファウンドリ事業を軸・強みとして事業展開を進めていきます。

#### ステークホルダー

ステークホルダーを、顧客・取引先・社員・株主・地域社会の人々等、私たちに関連するすべての人や団体と定義します。

#### 信頼

会社として個人として、ステークホルダーと**相互に信頼関係にあるパートナー**となることを目指します。

#### 持続的成長

信頼をベースに、ステークホルダーと共に持続的に成長していく企業を目指します。

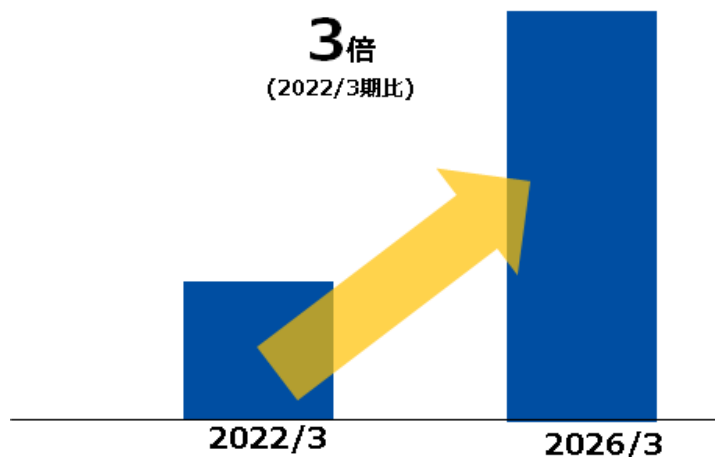
## トレックス メインFABの一つとして鹿児島工場生産能力増強

- ・ アナログ電源IC 生産能力増強
- ・ 生産能力増強に関わる設備投資  
3年計画 23.3期~25.3期 総額44億円  
(25.3期 投資計画最終年度 10億円を計画)
- ・ 2024年2月9日 クリーンルーム増床 竣工式
- ・ 順次 生産装置を搬入 稼働に向けて立上げ中

### 竣工式

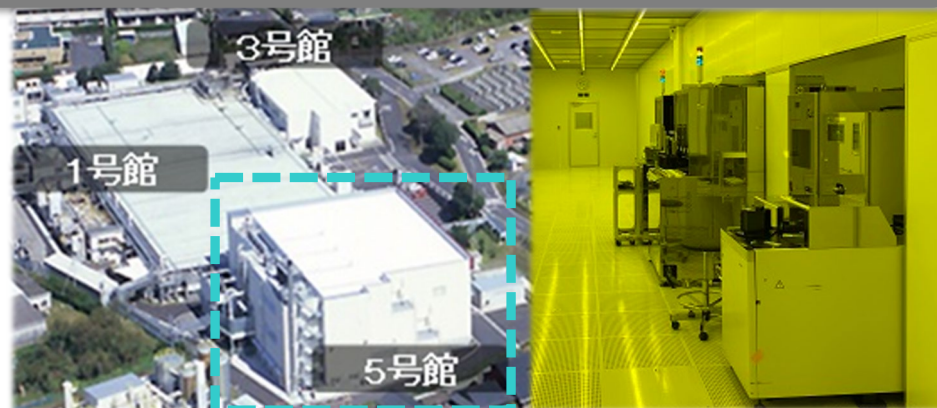


### トレックス製品 生産能力枚数推移



トレックス製品の長期安定供給を実現

### 鹿児島工場5号館3階をクリーンルーム化



## 鹿児島工場の取組み

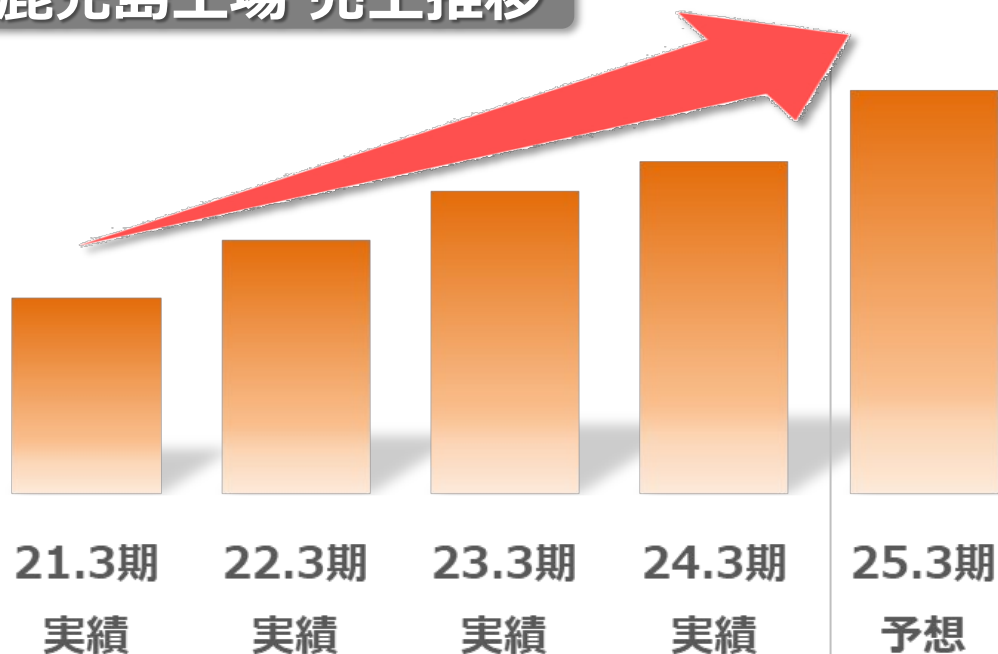
- ✓ 事業計画達成に向けた生産能力増強
- ✓ 製造固定費削減による安定した収益の確保
  - ・組織体制の改善
  - ・消耗品、修繕、消費電力削減
  - ・労働生産性向上によるCT短縮

24.3期 営業利益

2015年10月  
工場取得以降

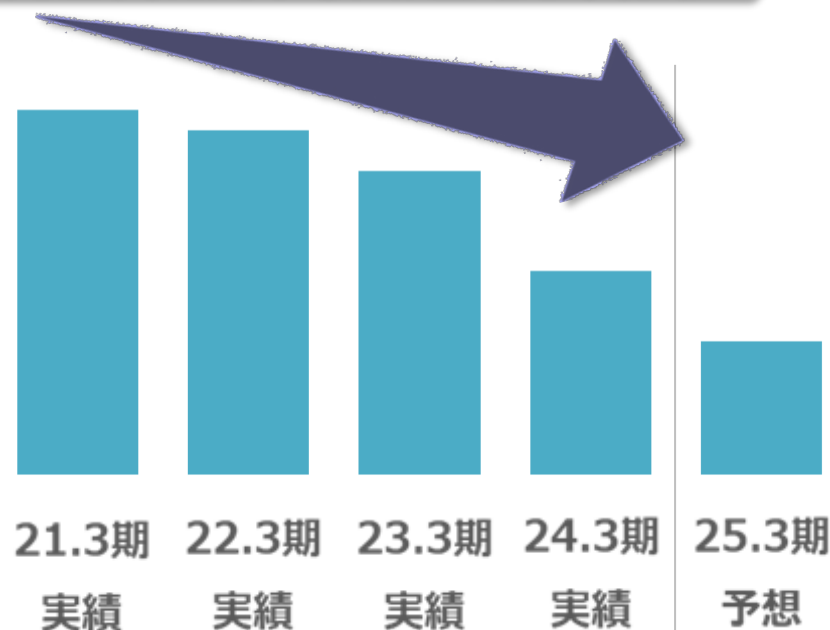
初の通期黒字化達成

### 鹿児島工場 売上推移



25.3期 2万枚/月 安定した生産体制へ

### 売上高に対する固定費比率推移



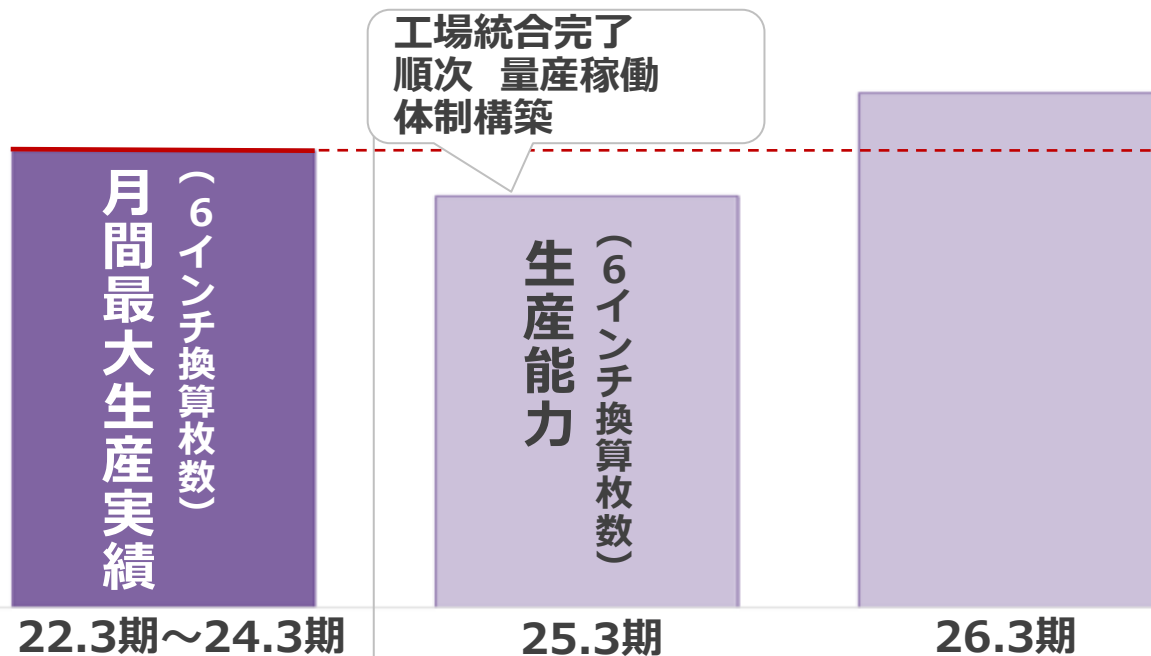
製造コスト削減により固定費比率低下

## 岡山工場の取組み

- ✓ 第2工場 Siデバイスの生産を終え、第1工場に集約を実現
- ✓ 既存装置の生産性を追求
  - ・交替勤務体制変更により働き方改革の実現と設備稼働率向上を目指す
  - ・固定費・変動費削減を追求

### 岡山工場 生産実績/生産能力推移

工場統合に伴いインチサイズアップすることで生産能力を拡大



### 岡山第2工場

当社創業の地 岡山第2工場は Siデバイス生産という一つの役割を終えました

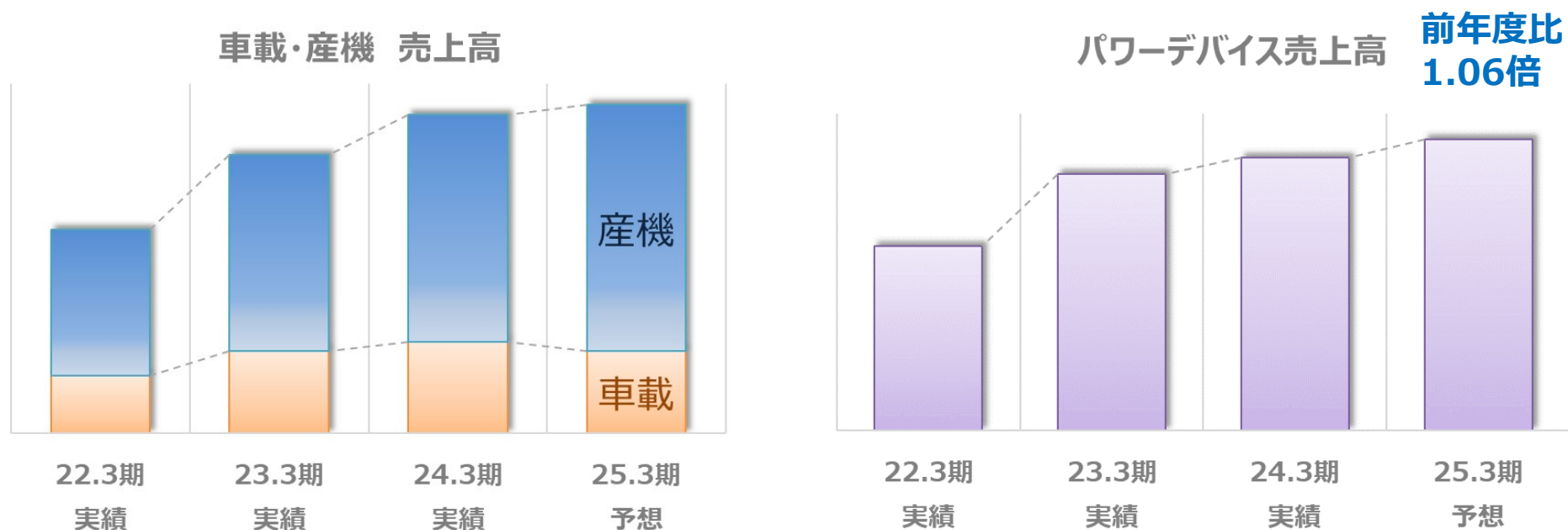




## Siパワーデバイスの受注は引き続き高水準を維持

要因：自動車の電動化、産業機器、5G、新エネルギーなどの需要好調

デバイス：IGBT、MOSFET、SBD



## 化合物半導体材料に対応したプロセス技術開発 パワー半導体供給ニーズに応える

取扱い：炭化ケイ素 (SiC)、酸化ガリウム (Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、窒化ガリウム (GaN)

✓市場要求に応えるパワー半導体の開発により更なる売上アップを目指す

## Siパワーデバイス開発計画

24.3期

25.3期

26.3期

27.3期

新たなパワーデバイス開発により更なる売上アップを目指す

### ★ Low Vth MOSFET 量産中

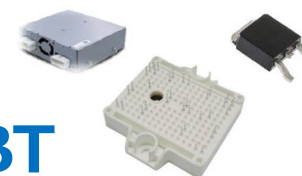
医療系、産業系など高密度実装機器をターゲットに低電圧駆動（1.5V以下）製品を開発

・ラインナップ拡充中

### ★ スプリットゲート型MOSFET

低オン抵抗を実現し、より小さなパッケージで高い電流密度を実現(電池の長寿命化等貢献)

・試作評価中



### ★ フィールドストップ型IGBT

フィールドストップIGBTの先端性能を目指した開発  
高入カインピーダンス、高いスイッチング速度、高耐圧且つ低オン抵抗素子

・25.3期Q4量産予定

シナジー効果

トレックス・フェニテックはパワー半導体を共同企画・開発 このモジュール開発には、当社のパワー半導体生産技術が多分に活かされます

### ★ ハイパフォーマンス ショットキーバリアダイオード

デバイス構造の変更により、VF/IRのトレードオフを大幅に改善  
リーク電流を抑えることで、ジャンクション温度150°C保証が可能に

・25.3期Q4量産予定

## SiCオリジナル品

SBD

650V 10A Gen.2,3

650V 6,8,10A Gen.4

650V 20A Gen.2,3

1200V 10A Gen.2,3

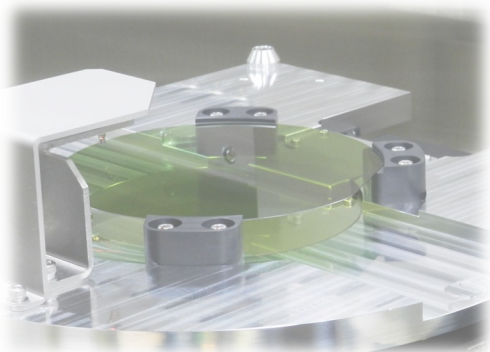
✓ 今後も市場要望にスピーディなシリーズ拡充で対応

・第2,3世代 サンプル提供中/顧客評価中

MOS FET

1200V 20A Planar/Trench

- ・プレーナー型 設計完了/サンプル作成開始  
サンプル提供 25.3期Q3予定
- ・トレンチ型 開発中



当社設計オリジナル品SBDは  
開発を終え、  
**量産フェーズへ移行しました**

## SiCファウンドリ事業

MOSFET

- ・ファウンドリ品を量産中
- ・新規顧客開拓中

➤ オリジナル品、ファウンドリ品の生産による相乗効果で  
付加価値の高い製品・ウエハ加工技術を提供します

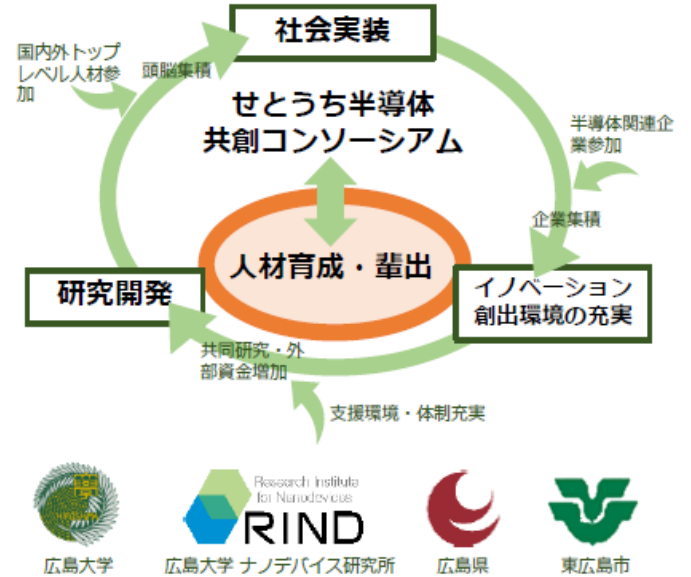
## 広島大学 ナノデバイス研究所 ジイノベ HUB棟建設支援

当社は、せとうち半導体共創コンソーシアムに参画企業版ふるさと納税を利用し、ナノデバイス研究所ジイノベ HUB棟建設に支援を行いました。

### 広島大学 ナノデバイス研究所 東棟



ナノデバイス研究所 東棟に当社看板が設置されました



### ジイノベ HUB棟ロビー



デザイン看板に当社ロゴが入りました

## 第38回 ネプコンジャパン

## 第1回 パワーデバイス&モジュール EXPO

### ネプコンジャパン パワーデバイス&モジュール EXPOへ初出展しました

- ✓ パワーデバイス ファウンドリ会社としての知名度向上
- ✓ 自社開発のパワーデバイス開発製品紹介
- ✓ ファウンドリビジネス紹介

当社が取り組むSiC・Ga2O3の問い合わせが多く、改めて化合物半導体への注目度の高さと可能性を実感した3日間となりました。

#### 開催日

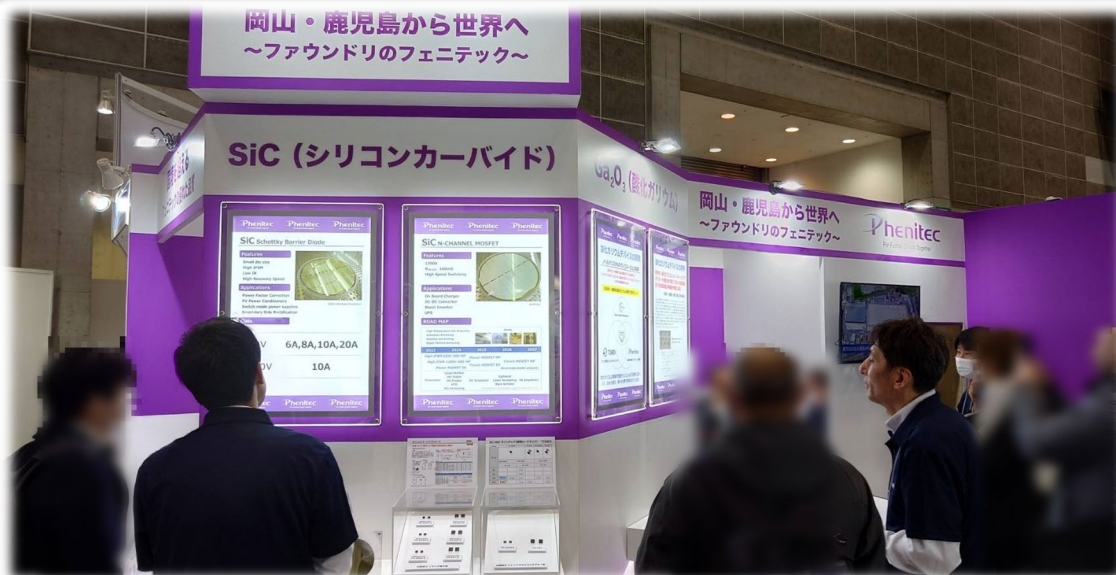
2024年1月24日(水)~26日(金)

#### 会場

東京ビッグサイト 東6ホール

#### 出展コンセプト

岡山・鹿児島から世界へ  
~ファウンドリのフェニテック~



当社ブースは大変大きな反響をいただき、たくさんの方々にお越しいただきました



当社生産品ウェハ(シリコン・SiC)などを展示しました

2024.2

## 岡山大学 大学院単位認定講座 & 社会人向け公開講座 「先端半導体テクノロジー」講演

半導体に関連する最新の先端技術をカバーするための、専門家をゲスト講師として登壇しました。

当社の半導体の経済安全保障上の重要性、これからの半導体産業の成長性などを紹介。半導体人材育成に貢献させていただきました。

✓ 今後も開講が予定されていますが、当社も引き続き貢献してまいります。

### 「産」と「学」の連携の推進について

<<深みと幅のある教育の取組>>

理論・学術  
に強み

教育現場



- ・出前授業
- ・研修/インターンシップ
- ・工場見学



シミュレーション  
仮説検証

マッチングによる産と学の協働教育  
教育の充実



実体験/現場  
に強み

企業



- ・人的支援
- ・実体験（教育環境）、  
の場、教材の提供



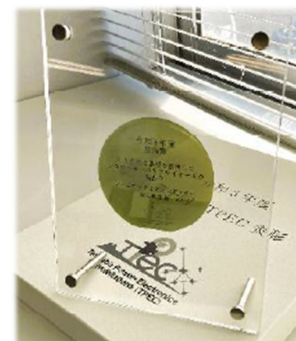
当社担当講師 講演の様子

✓ 産学官連携して人材育成プログラム及び人材確保実行プランを推進していきます。

2023.12

## 当社が国立研究開発法人産業技術総合研究所から「TPEC技術賞」を受賞

この賞は産業技術総合研究所で共同研究をしている企業の中から優れた開発を行い、それをビジネスにつなげる事ができた成果を表彰するものです。当社は、共同研究の開発技術を用いて、「貼り合わせ基板を使用したショットキーバリアダイオードの製品化」を成し遂げました。



2024.1

## 電子デバイス産業新聞主催セミナー「SiCとGaN 半導体ビジネス最前線」に登壇

来場・オンライン参加を含め国内外から数多くの方が参加がある中、当社のSiC事業「SiCパワー半導体のファウンドリ戦略」を紹介しました。



# Appendix 会社紹介



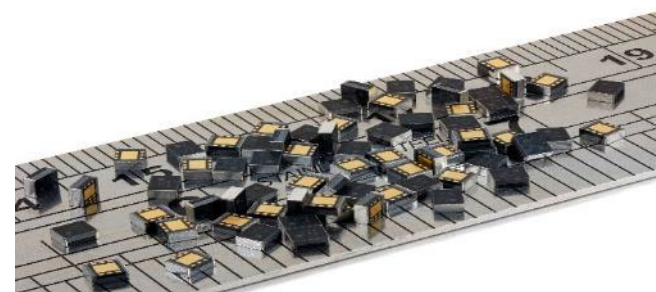
1995年に設立。2014年にJASDAQスタンダード市場に上場、東証二部、一部を経て、2022年4月に東証プライム市場に移行した半導体メーカーです。

## アナログのチカラ

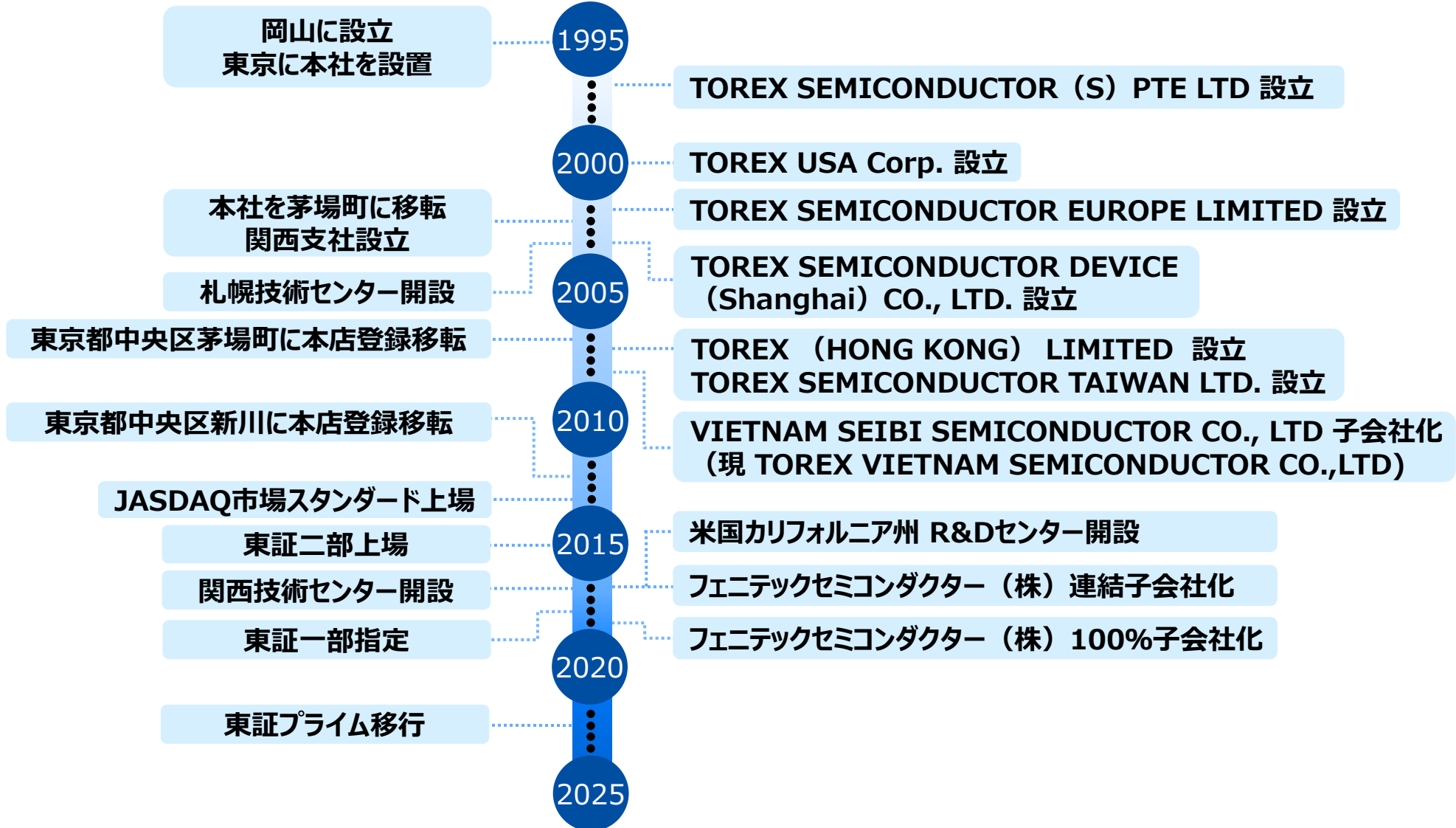
ABOUT TOREX

所在地	東京都中央区新川1-24-1 DAIHO ANNEX 3F
代表者	代表取締役社長 木村 岳史
資本金	29億6793万円（2024年3月31日現在）
事業内容	1.半導体デバイスの開発、設計製造 2.半導体デバイスの販売
従業員数	当社：190名 / グループ：1,042名
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
単元株式数	100株
決算期	3月末日
証券コード	6616
URL	<a href="https://www.torex.co.jp/">https://www.torex.co.jp/</a>

常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄することを企業の理念とする。



電源IC一筋、**省電力・小型化**の技術でエレクトロニクス産業の発展に貢献してきました。



TOIREX



## トレックス・ セミコンダクター

**ファブレスメーカー  
アナログ電源IC専業**

強み

- ・省電力／小型化の技術
- ・蓄積されたアナログ回路ノウハウ
- ・マーケティングと製品企画力
- ・フレキシブルな生産工場
- ・高品質をキープするQC
- ・ワールドワイドの製品販売網

Phenitex  
For Further Growth Together



## フェニテック セミコンダクター

**半導体受託専業(ファウンドリ)  
ディスクリート、パワーデバイス、  
CMOSアナログプロセス**

強み

- ・高品質を支える生産ノウハウ
- ・長期安定供給のJapanFab
- ・車載 IATF16949取得工場
- ・専門性の高い製造対応力
- ・オリジナルデバイスの開発力
- ・パワーデバイスの開発力



## トレックス・ セミコンダクター グループ

- ・顧客第一に徹した、小回りの利く対応力
- ・積極的なコラボレーションやM&Aによる協力関係の構築

**ファブレス&ファウンドリ  
それぞれが本業を突き詰めたプロ集団となり、  
相互補完でシナジーを発揮する。**

- 国内に東京本社を含む 8 拠点、海外に9つの拠点を設け、世界の需要に対応しています。



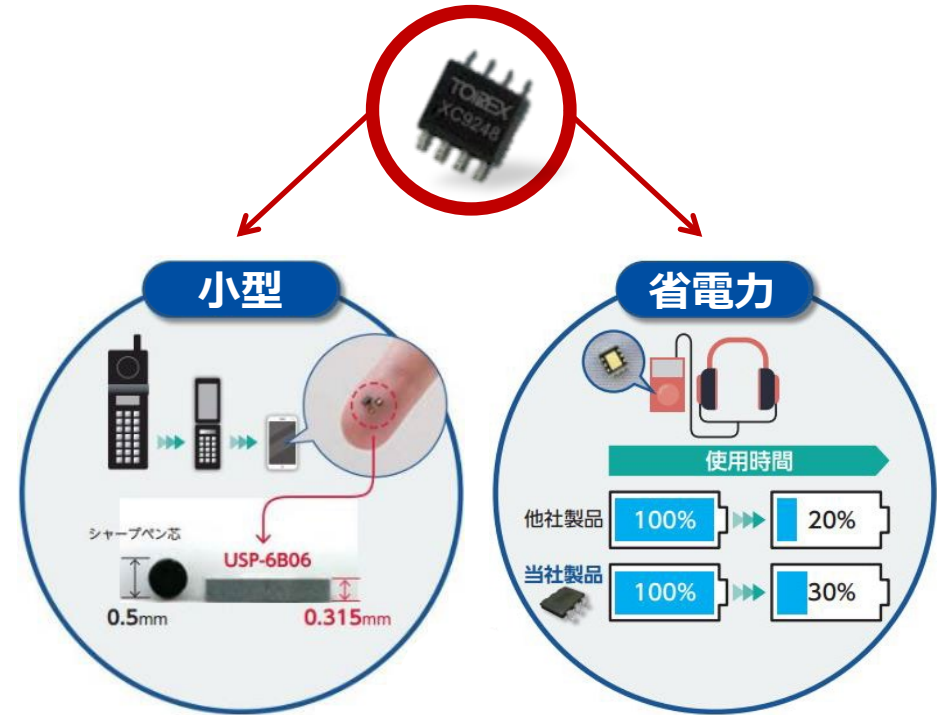
- 世界トップクラスの小型・省電力電源ICを開発・販売しています。

## 電源ICの役割



電子機器の様々な機能を動かすために  
電圧を制御し安定供給する

## TOIREXの電源IC



独自の技術で電子機器の  
小型化、省電力化に貢献

	トレックス・セミコンダクター	フェニテックセミコンダクター
事業形態	ファブレス	ファウンドリ
主な製品	<p style="background-color: #FFD700; text-align: center; padding: 5px;"><b>省エネに貢献するキーデバイスを提供</b></p> <p><b>電源IC</b></p>	<p><b>ディスクリート パワー半導体 (SiC、GaN、酸化ガリウム)</b></p>
今後の重点市場	<p><b>産業機器</b> 5G、IoTモジュール 全固体電池モジュール</p> <p><b>車載機器</b> 自動運転、ADAS、車載カメラ 電子ミラー他、様々なECU</p>	<p><b>産業機器</b> 産業用ロボット、鉄道、インバータ 発電施設（風力・太陽光）、パワーコンディショナー</p> <p><b>車載機器</b> EV向けパワー半導体 電装品</p>



**5G**



**IoT**



**自動運転**



**EV**

**本資料に記載された内容は、2024年5月17日現在において一般的に入手可能な情報と、合理的と判断する一定の前提に基づき、当社が作成したものです。**

**本資料に記載されている当社の中期計画、見通し等に関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。**

**実際の業績は、これらの要素により本資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。**

**投資に関するご決定をされる際、本資料のみに全面的に依拠することはお控えいただき、みなさまご自身のご判断でなされるようお願い致します。**

# Powerfully Small!

常に豊かな知性と感性を磨き、  
市場に適応した価値ある製品を創出し、  
豊かな社会の実現と  
地球環境の保全に貢献するとともに、  
私たちの事業に携わるすべての人々が  
共に繁栄すること

